



Proisol SMD – клей для поверхностного монтажа электронных компонентов

Описание

Proisol SMD – Российский клей для поверхностного монтажа электронных компонентов

Преимущества

- оптимальная для нанесения вязкость
- наличие тиксотропности
- подходит для ручного и автоматизированного нанесения
- стабильная форма наносимых точек
- контрастный красный цвет
- отверждение в процессе пайки по стандартным термопрофилям (низко-, средне- и высокотемпературные)
- отличная адгезия к поверхности печатной платы и другим материалам, применяемым в электронной технике
- высокие диэлектрические характеристики

Произведено в России
MADE IN RUSSIA

Срок хранения:

- 2 месяца при температуре 15...20 °С
- 6 месяцев при температуре 0...5 °С
- 12 месяцев при температуре -20...-15 °С
- Допускается использование клея после истечения указанных сроков в случае, если его вязкость позволяет наносить точки требуемого размера при дозировании.

Подготовка к работе с клеем

- В случае, если клей транспортировался или хранился при пониженной температуре, возможно увеличение его вязкости из-за частичной кристаллизации (обратимый процесс). В случае, если при нагреве до комнатной температуры клей остается излишне вязким, необходимо поместить его в таре производителя в термокамеру, разогретую до 50 °С на 1,5- 2,0 часа. После извлечения и охлаждения до температуры цеха клей готов к работе.
- Клей можно наносить на поверхность печатной платы ручным либо автоматическим дозатором (пневматический, винтовой и т.п.). Размер наносимых капель клея зависит от трех параметров: давление, внутренний диаметр иглы, доза (продолжительность действия повышенного давления). Перед началом работы необходимо подобрать параметры для получения требуемого результата.



Применение клея

- Клей наносят точками на поверхность печатной платы в области размещения SMD-компонентов (от 1 до 4 точек в зависимости от размера компонента)
- Клей является тиксотропным. Нанесенные капли сохраняют исходную форму
- При использовании клея для альтернативных задач возможно отверждение при других режимах при температуре 120 °С (технологическое отверждение – 10 минут), 140 °С (технологическое отверждение – 5 минут) и т.п.
- После установки компонента клей образует тонкую пленку. Оптимальная толщина 0,2-0,4 мм.
- Клей отверждается во время пайки в печи (конвекционная либо инфракрасная) по стандартным термопрофилям для низко-, средне- и высокотемпературных паяльных паст.
- После отверждения клей удерживает припаянный компонент при повторном нагреве в печи оплавления (двухсторонний монтаж), а также при эксплуатации изделия в условиях сильных вибрационных, ударных нагрузок

Транспортировка и хранение

- Клей транспортировать при температуре -20...+5 °С.
- Допускается перевозка в течение 2-4 дней при повышенной температуре (до 25 °С)
- Рекомендуется хранить клей при пониженной температуре (менее 5 °С).

Удаление клея

- Неотвержденный клей может быть удален растворителями (изопропиловый спирт, нефрас, этилацетат и др.)
- Клей после отверждения может быть удален термомеханически с использованием жала специальной формы

Артикулы доступные к заказу

Артикул	Наименование
SMD-10	Proisol SMD-10 клей для поверхностного монтажа электронных компонентов, шприц 10 гр .
SMD-30	Proisol SMD-30 клей для поверхностного монтажа электронных компонентов, шприц 30 гр .
SMD-1000	Proisol SMD-1000 клей для поверхностного монтажа электронных компонентов, упаковка 1000 гр .
SMD-5000	Proisol SMD-5000 клей для поверхностного монтажа электронных компонентов, упаковка 5000 гр .
SMD-20000	Proisol SMD-20000 клей для поверхностного монтажа электронных компонентов, упаковка 20 кг .